

## MANUFACTURE OF PLATED MATERIAL

**Patent number:** JP61064882  
**Publication date:** 1986-04-03  
**Inventor:** KANBE TOKUZO; others: 02  
**Applicant:** NIPPON CHEM IND CO LTD:THE; others: 01  
**Classification:**  
- international: C23C18/28  
- european:  
**Application number:** JP19840184519 19840905  
**Priority number(s):**

### Abstract of JP61064882

**PURPOSE:**To obtain a plated plastic material by supporting noble metallic ions on a plastic material with a surface treating agent having noble metal capturing action and by forming a metallic film having high bonding strength by electroless plating.

**CONSTITUTION:**Phenol resin powder is well mixed with an aminosilane compound such as gamma-aminopropyltriethoxysilane as a surface treating agent having noble metal capturing action and an aqueous PdCl soln., and the mixture is dried and held at about 110 deg.C to support Pd ions on the surface of the powder. This powder is put in an electroless plating, soln., preferably an electroless nickel plating soln., and plating is carried out under stirring to obtain nickel plated powder. By this method a plated material suitable for use as a resin additive for providing electric conductivity is obtd.

---

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-64882

⑬ Int.Cl.<sup>4</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)4月3日

C 23 C 18/28

7011-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

⑮ 発明の名称 めつき材料の製造方法

⑯ 特 願 昭59-184519

⑰ 出 願 昭59(1984)9月5日

⑱ 発 明 者 神戸 徳 蔵 我孫子市泉38-17

⑲ 発 明 者 川 上 浩 東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社  
内

⑳ 発 明 者 熊 谷 八 百 三 新治郡樺村吾妻二丁目805-204

㉑ 出 願 人 日本化学工業株式会社 東京都江東区亀戸9丁目15番1号

㉒ 代 理 人 弁理士 曾我 道照 外3名

㉓ 出 願 人 工業技術院長

㉔ 復代理人 弁理士 曾我 道照 外3名

明 細 書

1 発明の名称

めつき材料の製造方法

2 特許請求の範囲

- 1 合成樹脂材を予備処理後無電解めつき処理して合成樹脂めつき材を製造する方法において、合成樹脂材に貴金属捕捉性表面処理剤にて貴金属イオンを担持させた後に無電解めつき処理することを特徴とする、めつき<sup>材料</sup>の製造方法。
- 2 合成樹脂材がフェノール樹脂粉末である特許請求の範囲第1項記載のめつき材料の製造方法。
- 3 貴金属捕捉性表面処理剤がアミノシラン系化合物である特許請求の範囲第1項記載のめつき<sup>材料</sup>の製造方法。
- 4 貴金属イオンがパラジウムイオンである特許請求の範囲第1項記載のめつき<sup>材料</sup>の製造方法。
- 5 無電解めつきが無電解ニッケルめつきであ

る特許請求の範囲第1項記載のめつき<sup>材料</sup>の製造方法。

3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はめつき<sup>材料</sup>の製造方法、更に詳しくは合成樹脂粉末の粒子表面に付着力の優れた無電解めつきによる金属皮膜を形成してなるめつき材の製造方法にかかり、その目的とするところは、導電性の塗料あるいは、導電性を付与するための樹脂添加剤に適しためつき<sup>材料</sup>を提供することにある。

従来の技術

一般に、無機又は有機の素材を問わず、その表面に無電解めつき皮膜を形成することは公知である。近時、帯電防止や、電磁波シールドの分野で、各種の導電性材料の開発が盛んであるが、その一つに無機粉末上に無電解めつきした導電材料の発案がなされている。

しかし一般に無機粉末のめつき品は、めつき皮膜は比較的良好であるけれども比重が大きい

ために合成樹脂や塗料ビヒクルへの配合の際に分散性が悪いなどの欠点がある。

他方、このためについで最近有機素材として樹脂粉末に対して無電解ニッケルめつき皮膜を形成した導電材料の提案がなされた(特開昭57-102953)。

無電解めつきを行う場合、通常、素材に対してエッチング増感又は活性化等の前処理操作を施し、その代表的なものとしては、例えば次の3つの方法があげられる：

- III 感受性化処理(可溶性第1銅塩例えば塩化銅/銅弗化第1銅の1〜10g/g塩酸酸性水溶液に常温で分散浸漬又はスプレー処理)→酸媒化処理(0.1〜1g/g塩化ベラジウム/銅の塩酸酸性水溶液に常温で分散浸漬又はスプレー処理)→無電解めつき；
- IV 酸媒化処理(0.1g/g塩化ベラジウム、1〜1g/g塩化第1銅の塩酸酸性コロイダル水溶液に常温で分散浸漬処理)→活性化処理(塩酸又は硫酸の10〜20%又は苛性ソーダ

の10〜20%水溶液に常温で分散浸漬処理)→無電解めつき。

これら従来法はいずれも予じめ化学的(クロム酸-硫酸混液に50〜70℃で数10分浸漬)又は機械的に被めつき物表面を荒らさないといめつき皮膜の付着性が悪い。しかし粉末は機械的に荒らすことはできず、又化学的にエッチングすると細かい粒子は溶解してしまう危険があり、又伊過、水洗作業も困難であり、排水処理にも手間がかかるだけでなく経済的にも問題がある。

しかし、上記のように、従来の前処理を施して無電解めつきしても合成樹脂基材は一般に疎水性であるのみならず、無機基材と比べて弾性があるため、めつき皮膜の付着力が弱い。

特に、合成樹脂への配合において、各種のミキサーでめつき粉体と混合する際に摩擦作用をめつき皮膜に及ぼすためにめつき皮膜のクラックや剥離が生じて所期の目的とする導電性が得られないことが多い。

発明が解決しようとする問題点

このようにことから、本発明は合成樹脂表面に付着力の大きなめつき皮膜を形成させることにある。即ち、本発明は従来のように合成樹脂表面を化学的又は物理的にエッチングすることなしに、ある種の貴金属捕捉剤を用いて貴金属を該表面に担持させることによつて強固な無電解めつき皮膜が形成されることを知見し、本発明を完成したものである。

問題点を解決するための手段

すなわち、本発明の要旨とするところは、合成樹脂材を予備処理後、無電解めつき処理して合成樹脂めつき材を製造する方法において、合成樹脂材に貴金属捕捉性表面処理剤にて貴金属イオンを担持させた後に、無電解めつき処理することを特徴とするめつき材の製造法にかゝる。

本発明において、めつき素材は合成樹脂材であれば合成樹脂の種類は問わない。

これら合成樹脂の例としてフェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエスナル樹脂、ナイロン樹脂、ポリホレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポ

リスチレン樹脂、ABS樹脂等があげられる。

また、樹脂の形状は球形、だ円形、繊維状等と如何なる形状又は成置物であつてもよく、又大きさも特に限定しない。

本発明は上記の如き、合成樹脂基材に無電解めつき処理するに際し、前処理として樹脂基材の表面に貴金属イオンを該金属捕捉性表面処理剤にて担持させる処理を行うことを特徴とする。

本発明において貴金属捕捉性表面処理剤というのは、カルボキシル基、エステル基、アミノ基、水酸基、ニトリル基、ハロゲン基、シリコン又はチタンに結合するアルコキシ基等の官能基を少なくとも1個以上有する有機化合物であつて貴金属イオンをキレート化又は塩を形成しうるものをいう。

かかる貴金属捕捉性表面処理剤としては、例えばγ-アミノプロピルトリエトキシシラン、γ-メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン、N-β-アミノエチル-γ-アミノプロピルトリエトキシシラン等のアミノシラン化合

物、ヘキサメチレンジアミン、トリメチレンジアミン、ジアミノドデカン等のアミノ化合物、マレイン酸、セバシン酸、アジピン酸等のジカルボン酸、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ジグリコールアミン等のグリコール化合物、マロンニトリル、ポリアクリロニトリル等のニトリル化合物、イソプロピルトリ(ジオクタチルピロフオスフェート)チタネート、チタニウムジ(ジオクタチルピロフオスフェート)オキシアセテート、イソプロピルトリイソステアロイルチタネート等のチタネート化合物、マレイン化ポリブタジエン、末端カルボキシ化ポリブタジエン、末端グリコール化ポリブタジエン、アクリロニトリル/ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、等のブタジエン重合体、リノール酸、リノレン酸等の不飽和脂肪酸、が用いられる。

また、ここで貴金属というのは化学めつき液からめつき基材表面、例えば粉体表面に金属を析出させる際の触媒効果を示す貴金属をいい、

例えばパラジウム、白金、金等があげられるが、パラジウムが最も好ましい。

樹脂基材の表面に貴金属イオンを上記表面処理剤にて担持させるにはこの表面処理剤を適当な溶媒例えば水、又はエチルアルコール、アセトン、トルエン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ジオキサン等の有機溶媒に溶解させて溶液とし、この溶液にめつき基材である例えば合成樹脂粉体を浸漬等の方法により常温又は加熱下に接触させた後、溶媒を揮散させる蒸気法や、ヘンシエルミキサー等を用いて機械的に溶液を被覆させる乾式法等がある。溶液中の表面処理剤濃度および使用量はめつき基材の例えば粉体の表面積や物性等あるいは表面処理剤や溶媒等の種類によつて異なるものの特に限定はないが、少なくとも合成樹脂のめつき基材表面に該表面処理剤の単分子層が形成しうる量を必要とする。

上記表面処理剤にて該表面に貴金属イオンを担持させる方法としては、該表面処理剤と貴金

属イオンとの混合溶液を予め調整して上記の如き処理で行う場合や、予め上記の如き表面処理した後、次いで貴金属塩水溶液にて浸漬やスプレーあるいは浸漬混合操作にて行う場合があげられる。

溶媒が水の場合には前者の方法にて予め貴金属イオンを表面処理剤にて捕捉させた溶液にて処理する方が操作上好ましい。

なお、いずれの場合にも例えば塩化貴金属塩の如き可溶性貴金属塩の濃度は0.05~0.5g/lが好ましい。

かくしてめつき基材表面に貴金属を担持させた後は溶液を加熱又は風乾など所望の方法にて除去し乾燥する。

なお表面処理剤が加熱において脱水縮合するようなものについては単に溶媒の揮散のみならず、0.5~3時間110~150℃で加熱処理を更に施してキュアリングさせることが好ましい。

合成樹脂めつき基材に対する貴金属イオンの担

持はそれらの種類や表面処理剤の種類あるいは使用目的によつて一様ではないが、多くの場合メタルとして0.001~0.1重量%、好ましくは0.01~0.05重量%の範囲が適当である。

このように、前処理を施した後に次いで無電解めつき処理を施す。

本発明においてはどのような有機系材料に対して、化学めつき処理を施し、その表面に金属皮膜を形成させるが、この場合、その化学めつき液としては従来公知の種々のものを採用することができる。また、めつき液中に対して、めつき基材の表面皮膜形成のために添加する金属としては、種々の金属を挙げることができ、例えばNi、Co、Ag、Au、Cu、Pd、Pt、Rh、Ru、Fe等が挙げられる。また、めつき基材の表面に形成させる金属皮膜は、単独の金属の純、合金、例えばNi-Co、Ni-W、Ni-Fe、Co-W、Co-Fe等から構成させることもできるが、合金皮膜を形成させる場合には、めつき液には、所望に応じた複数の金属塩を添加すればよい。

この場合の化学めつき処理は、従来公知の方法に従って行うことができ、一般的には、金属塩、還元剤、錯化剤、緩衝剤、安定剤等を含むめつき液が採用される。この場合、還元剤としては、次亜リン酸ナトリウム、水素化ほう素ナトリウム、アミノボラン、ホルマリン等が採用され、錯化剤や緩衝剤としては、酢酸、酢酸、コハク酸、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、グリシン、エチレンジアミン、EDTA、トリエタノールアミンなどが採用される。

化学めつき液の代表的組成として、例えば、金属塩10～200g/l、次亜リン酸塩0.5～50g/l、pH 緩衝剤5～300g/lからなるものを挙げることができ、また、好ましくは、このようなめつき液に対して、さらに補助添加剤としてグリシン5～200g/lを添加することができる。また、他のめつき液として、金属塩10～200g/l、カルボン酸塩10～100g/l、水酸化アルカリ10～60g/l、炭酸アルカリ5～30g/l、ホルマリン10～200mg/l

からなるものでその代表的なめつききる金属として銅、銀を挙げることができる。

化学めつき処理は通常、温度20～75℃で、基材表面に均一な皮膜が形成されるように、攪拌、例えば空気攪拌を行いながら実施するのが好ましい。

化学めつき処理を行う場合、通常は予め調製された化学めつき浴に予備処理した粉末を添加して行われるが本発明はめつき基材が粉末の場合水や希釈されためつき処理液又はめつき老化液あるいはめつき調剤を調製する一部の溶液を分散液として粉末を均一分散させたスラリー中に化学めつき液を添加してめつき処理することできる。

本発明による表面に金属皮膜を有する合成樹脂粉末にあつては、金属光沢を示すと共に、導電性を有し、様々な充填剤、例えば、増強剤、着色剤、増粘剤等として適用される。特に、プラスチックやゴムに対する充填剤として有利に適用される。

本発明の金属皮膜を有する合成樹脂粉末は、これをプラスチックに對し、10～70重量%程度添加することにより、プラスチックに対して、加飾性、電磁シールド性、帯電防止性、機械的強度を付与することができ、このようなプラスチック組成物は、フィルム、シート、パイプ、その他の成形体材料として好適である。

次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

#### 実施例1～11

平均粒径2.5μmのエポキシ樹脂粉末10gを、第2表に示すような様々な官能基をもつ有機化合物を溶剤（水、エタノール、トルエン、アセトン、ジメチルホルムアミド等）100mlに溶解させた濃度0.5～1.0重量%の溶液に攪拌しながら室温で1時間浸漬させた後、温度110℃で乾燥し溶媒を揮散させた。次に0.1g/lの塩化パラジウムの塩酸酸性水溶液100mlに攪拌しながら室温で10分浸漬した後、100mlの蒸留水で1回水洗してパラジウムイ

オンを樹脂粉末に担持させた。次に、この前処理されたエポキシ樹脂粉末を第1表/第2表の組成の無電解ニッケルめつき液中に投入し、攪拌しながら60～75℃の温度でめつき処理し金属化率70%のニッケルめつき粉末を得た。

第1表 ニッケルめつき浴組成

無電解ニッケル	25g/l
次亜リン酸ソーダ	25g/l
クエン酸ソーダ	30g/l
酢酸ソーダ	15g/l
pH（炭酸又は苛性ソーダ）	4.5～5.5

得られためつき粉末を蒸留乳鉢に少量取り、30秒間乳鉢でこすった後顕微鏡でめつき皮膜の剥離程度を観察した。その結果を第2表に外觀、導電性と合せて示す。なお導電性はテスターにて測定した。表中に示した符号○は良好、△はやや劣ることを示す。

表 3

実施例	表面処理剤	付着力	導電性	外観
1	γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	○	○	○
2	N-β(アミノエチル)γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	○	○	○
3	γ-メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン	○	○	○
4	トリメチレンシアミン	△	○	○
5	ジアミノドデカン	△	○	○
6	マレイン酸	△	○	△
7	イソプロピル(βエチルアミノ)チオホート	△	○	○
8	リノール酸	△	○	△
9	ポリメチルメタアクリレート	○	○	○
10	ポリアクリルニトリル	○	○	○
11	ポリブタジエン	△	○	△

実施例 12~18

平均粒径  $2.2 \mu\text{m}$  のフェノール樹脂粉末  $5.0 \text{ g}$  を表 3 に示す種々のシランカップリング剤  $7.5 \text{ mg}$  及び塩化パラジウム  $7.5 \text{ mg}$  の水溶液

を  $1 \text{ g/g}$  塩化銅 / 塩化銅酸性水溶液  $500 \text{ mL}$  に投入し、 $45$  分間攪拌後、戸過し、 $1$  回脱塩水で洗浄した。次に  $0.1 \text{ g/g}$  塩化パラジウム塩化銅酸性水溶液  $500 \text{ mL}$  に添加して  $10$  分間攪拌後戸過し、 $1$  回脱塩水で洗浄した。このようにして前処理を終えた粉末を実施例 1~11 と同じ無電解ニッケルめつき液中に投入し攪拌しながら  $60 \sim 90^\circ\text{C}$  の液温でめつき処理し、金属化率  $40\%$  のニッケルめつき粉末を得た。

得られためつき粉末  $9.72 \text{ g}$  を実施例 12~18 と同一の方法で板を成形し、その体積固有抵抗を測定した所  $2.1 \text{ M}\Omega\text{-cm}$  であった。

実施例 15

実施例 13 と同様の方法で平均粒径  $2.2 \mu\text{m}$  のフェノール樹脂粉末を前処理し、次に表 3 に示す無電解銅めつき液に投入し攪拌しながら  $60^\circ\text{C}$  の液温でめつき処理し金属化率  $30\%$  の銅めつき粉末を得た。

$20 \text{ mg}$  とよく混合しながら乾燥し、更に  $110^\circ\text{C}$  で  $1$  時間保持してベタジウムイオンを粒子表面に担持させた。次いで、このようにして前処理を終えた粉末を実施例 1~11 と同じ無電解ニッケルめつき液中に投入し、攪拌しながら  $60 \sim 90^\circ\text{C}$  の液温でめつき処理し、金属化率  $40\%$  のニッケルめつき粉末を得た。

得られためつき粉末  $9.72 \text{ g}$  とエポキシ樹脂  $9 \text{ g}$  (体積分率  $45\%$ ) を乳鉢でよく混合し、 $5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ mm}$  の板を成形し、その体積固有抵抗を測定した。結果を表 3 に示す。

表 3 続

実施例	表面処理剤	体積固有抵抗
12	γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	$0.13 \Omega\text{-cm}$
13	N-β(アミノエチル)γ-アミノプロピルトリエトキシシラン	$0.10 \Omega\text{-cm}$
14	γ-メタアクリロキシプロピルトリエトキシシラン	$0.25 \Omega\text{-cm}$

比較例

平均粒径  $2.2 \mu\text{m}$  のフェノール樹脂粉末  $5.0 \text{ g}$

表 4

硫酸銅	$1.5 \text{ g/g}$
パラホルムアルデヒド	$1.5 \text{ g/g}$
EDTA- $\text{Na}$	$5.0 \text{ g/g}$
ジビリデル	$10 \text{ ppm}$
フエロシアン化カリ	$10 \text{ ppm}$

銅めつきしたフェノール樹脂粉末を次に表 5 に示す無電解銅めつき液に投入し攪拌しながら  $60^\circ\text{C}$  の液温でめつき処理し金属化率  $10\%$  の銅めつき粉末を得た。

表 5

シアン化銀カリ	$1.0 \text{ g/g}$
シアン化ナトリウム	$5 \text{ g/g}$
苛性ソーダ	$4 \text{ g/g}$
ほう素化水素カリ	$5.4 \text{ g/g}$

得られためつき粉末  $9.72 \text{ g}$  を実施例 12~18 と同一の方法で板を成形し、その体積固有抵抗を測定した所  $0.03 \Omega\text{-cm}$  であった。

実施例 16

合成樹脂調剤(フェノール-ナイロン混合系樹脂

手続補正書(自発)

昭和59年10月2日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和59年特許第184519号

2. 発明の名称

めつき材料の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名称 日本化学工業株式会社

名称 (114)工業技術院長

4. 代理人(日本化学工業株式会社の)

〒100

住所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

丸の内ビルディング4階

電話・東京(218)5811〔代表〕

氏名 (5787)弁理士 曾我道照

代理人(工業技術院長の)

〒100

住所 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号

丸の内ビルディング4階

電話・東京(218)5811〔代表〕

氏名 (5787)弁理士 曾我道照

5. 補正の対象

(1) 明細書の発明の詳細な説明の欄

方式

脂)の衣服用ボタン(直径1.5mm)30コを  
0.2重量部アークプロピルトリエトキシシ  
ランおよび0.02重量部塩化パラジウムの混合水  
溶液に入れて常温にて撹拌しながら30分間浸  
漬処理した後分取して水洗し、次いで乾燥した。

次いで、実施例ノと同様に無電解ニッケルめ  
つき処理を行つたところ、いずれのボタンも均  
一が強固できれいなニッケルめつき皮膜が形成  
されていた。

発明の効果

本発明にかかるめつき材料は、腐蝕下の抵抗性  
のある金属皮膜が形成されるので、電磁波シ  
ールド材料、帯電防止材料、導磁性顔料として効  
果的に使用できる。

まためつき処理に当り、予め化学的又は機械  
的に被めつき表面をエッチングに粗面化しない  
でめつき皮膜が形成されるので光沢性の優れた  
ものが得られる。

特許出願人 日本化学工業株式会社

同 工業技術院長

代理人 曾我道照

6. 補正の内容

明細書第2頁7~8行の「めつき材」を「めつき  
材料」と補正する。